

来場登録はこちらをクリック(無料)

南展示棟

会場案内図

会期 2025年1月22日[水]~24日[金] 10:00~17:00

会場 東京ビッグサイト

主催 RX Japan株式会社

©2024年11月27日現在。実際のレイアウトと異なる場合がございます。

4階 3・4ホール

スマート物流 EXPO A会場

Factory Innovation Week 2025

製造業 カーボンニュートラル展

スマート工場 EXPO IoT/AI/FAによる 製造革新展 B会場

ラウンジ

東海電子

サトー

TOA

アスローバ/AJS/SCSK/システムインテグレイター/トータルソリューション

アライドテレシス

RYODEN

インターネットイニシアティブ

三菱ケミカル エンジニアリング

Braveridge

伊東電機

三菱電機

協栄産業 三菱電機システムサービス

日本通運

安川電機

キャディ

リンクス

アスエネ

Tebiki

実績班長

エスマット

VRAIN Solution

バルカー

日鉄ソリューションズ

ニトエル

スマートスケープ

伊東商会

テレワークラウンジ

お目当ての会社の探し方

- 1 スマホで出展社検索サイトにアクセス
- 2 お目当ての会社を検索して小間番号を確認
- 3 小間番号から案内図でブースの位置をお探しいただき

スマート工場 EXPOは 東8ホールでも開催中

無料循環バス運行中

東展示棟 南展示棟

の移動にご利用ください(5分間隔)

お持ちの来場者バッジで、すべて入場可能

Factory Innovation Week 2025

スマート工場 EXPO A会場

スマート工場 EXPO B会場

製造業カーボンニュートラル展

スマート物流 EXPO A会場

スマート物流 EXPO B会場

ウェアラブル EXPO

ネココンジャパン 2025

インターネコジャパン

エレクトロテスト ジャパン

電子部品・材料 EXPO

プリント配線板 EXPO

微細加工 EXPO

Factory Innovation Week 2025

ロボテック

スマート物流 EXPO B会場

ネココンジャパン 2025

半導体・センサパッケージング展

パワーデバイス&モジュール EXPO

オートモティブ ワールド 2025

面電カ-エレクトロニクス技術展

コネクテッドカー EXPO

自動運転 EXPO

SDV EXPO

EV・HV・FCV 技術展

自動車部品&加工 EXPO

Maas EXPO

クルマのサステナブル技術展

カンパレンス会場

7階 国際会議場

6階 606, 608

1階 レセプションホールA, B

※2F共有部にあるコピー機前のエレベーターを乗得て1Fにお越しください

1階 1・2ホール

Factory Innovation Week 2025

ロボテック展 ロボット [開発]・[活用]展

スマート物流 EXPO B会場

ソリッドワークス

ハイワイン

TriOrb

アルテック/エルジエレクトロニクスジャパン

estie 矢崎総業

クラーリオンライフサイクルソリューションズ

ZO MOTORS

ブレインパッド BJT JAPAN

NECマグナス コミュニケーションズ

三共製作所

ニコン

日伝

HBA

日新

大同工業

パナソニック コネクト

ダット ジャパン

三菱ふそう トラック・バス

タカハタ 電子

シムトップス

オフィスステーション

セイノー 情報サービス

ハコベル

ヒューマノイド ロボット 特別展示ブース

DIC

UGO

Roboware

地方独立行政法人 東京都立産業技術研究センター

スギノマシン

京二

アドテック エンジニアリング

蒲田工業

光昭

東北エンタープライズ

ゼネテック

ロジザード

ロジテック

プライセン

Doog

ROMS

ユニバルス

Rapyuta Robotics

第一電通

荻原 エレクトロニクス

G-DOK INDUSTRIES

新機スタート エンジン

ピアブ ジャパン

北陽電機

オムロン GO

聖目トランス ネットワーク

日東工業

W&N ONTEJAPAN

アット・ファシリティアラボ

iPX

enstem

ナビタイム ジャパン

knevit

キャンパス クリエイティブ

Industry Alpha

アセンド

日本AVC

ブリヂストン ソフトロボティクスベンチャーズ

ユニバーサル ロボット

ファナック

浜正

京セラ

アイグリッドソリューションズ

Shippo

ソラコム

キャリアット

三信電気

愛知機械テクノシステム

TUNAG

Univearth

三菱倉庫

キーエンス

NTN

PLIBOT

Sansan

KDDI

Commercial Japan Partnership Technologies

YEデジタル

レクラス

理想科学工業

ロボットの進化を肌で感じる!

ヒューマノイドロボット 特別展示企画

会場: 南1ホール

小間番号: S1-31

詳細はこちら

・ヒューマノイドロボットを特別展示!

・デモンストレーション時間あり!

新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~への最新情報はこちら

申込不要。登録を希望される方は、直接会場へお越しください。

https://www.necconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference/ex-presentation.html

その他カンパレンス・フォーラムの最新情報はこちら

部、事前申込不要です。登録を希望される方は、お申込みの上、会場へお越しください。

https://www.necconjapan.jp/tokyo/ja-jp/conference.html

明日の現場を支える AutoID for DX

RFID 読み取り体験実施中

設備予備品管理

サトーブースへご来場ください S21-40

凡例

会場のパリアフリー設備については、こちらからご確認ください。

東展示棟 会場案内図は裏面へ

来場登録はこちらをクリック(無料)

東展示棟 会場案内図

2025年1月22日(水)~24日(金) 東京ビッグサイト RX Japan株式会社

お目当ての会社の探し方

- 1 スマホで出展社検索サイトにアクセス
- 2 お目当ての会社を検索して小間番号を確認
- 3 小間番号から案内図でブースの位置をお探ください



世界的なクルマのハッキングコンテストを開催中

会場: 東6ホール 小間番号: E58-E53

世界から集まったチームが、下記4領域のハッキングを競う!

- 自動車 (自動車メーカー)
- インフォテインメント (AV/AVC)
- 電気自動車 (EV)
- オペレーティングシステム (OS)

詳細はこちら: <https://vicone.com/jp/pwn2own-automotive>

新製品・新技術セミナー ~New Tech Trend~の最新情報ははこちら

申込不要、聴講を希望される方は、直接会場へお越しください。

<https://www.nepconjapan.jp/foxy/ja-jp/conference/ex-presentation.html>

その他カンファレンス・フォーラムの最新情報ははこちら

一部、事前申込制となります。聴講を希望される方はお申込の上、会場へお越しください。

<https://www.nepconjapan.jp/foxy/ja-jp/conference.html>

凡例

- トイレ 売店 Wi-Fi AED ラウンジ
- エレベーター コンセント

会場のVR/AR/VR/AR設備については、こちらからご確認ください。

NTT DATA SDV

東6ホール E57-E8

STANLEY Engineered Fastening

EV向けの優れた軽量化システム「プラズマを活用」 E58-8ブースでお見せします。

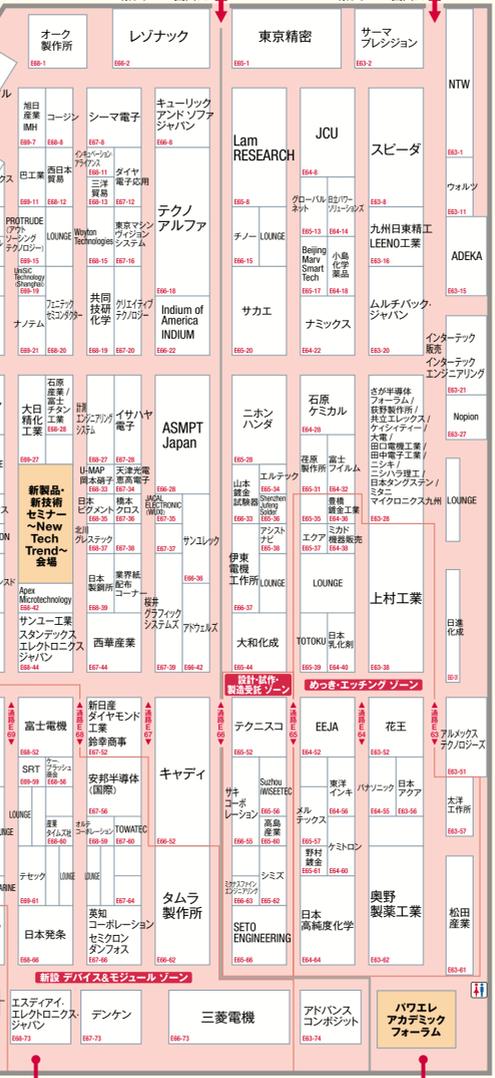
南展示棟 会場案内図は ←裏面へ

ウェアラブル EXPO

ウェアラブル 開発・活用展



スマート工場 EXPO A会場



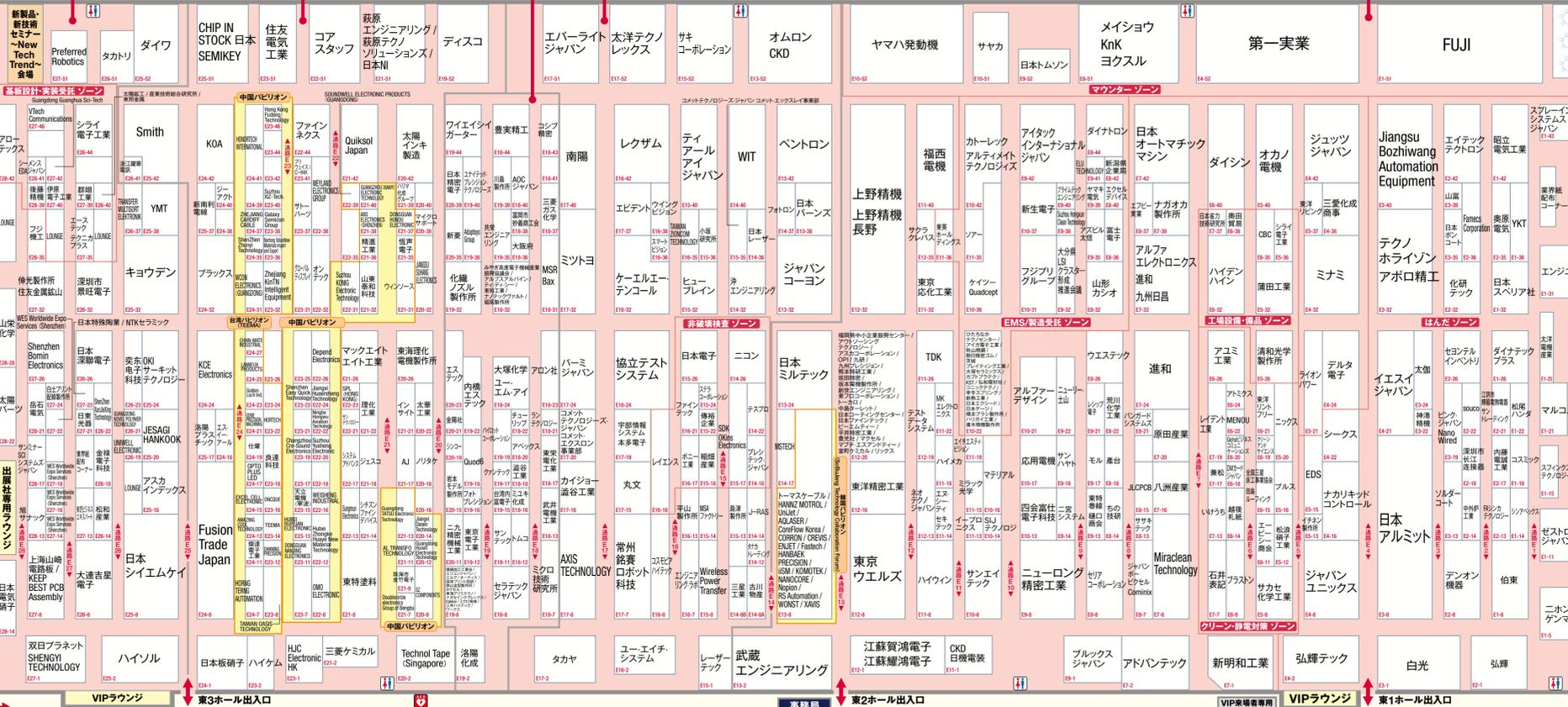
プリント配線板 EXPO

電子部品・材料 EXPO

微細加工 EXPO

エレクトロテストジャパン

インターネットジャパン

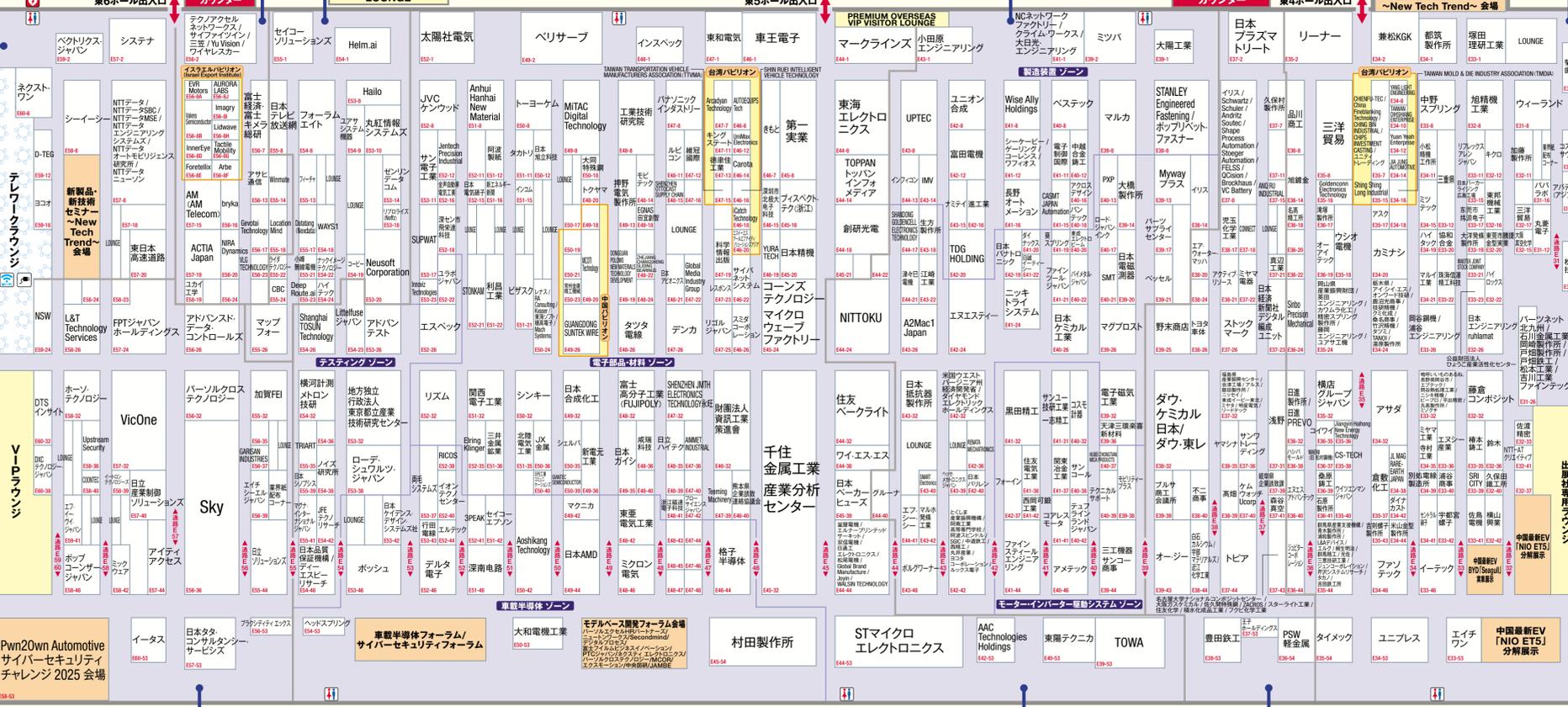


コネクティッドカー EXPO

自動運転 EXPO

EV・HV・FCV 技術展

自動車部品・加工 EXPO



パワーデバイス&モジュール EXPO

半導体・センサ パッケージング展

MaaS EXPO

SDV EXPO 車載ソフトウェア開発展

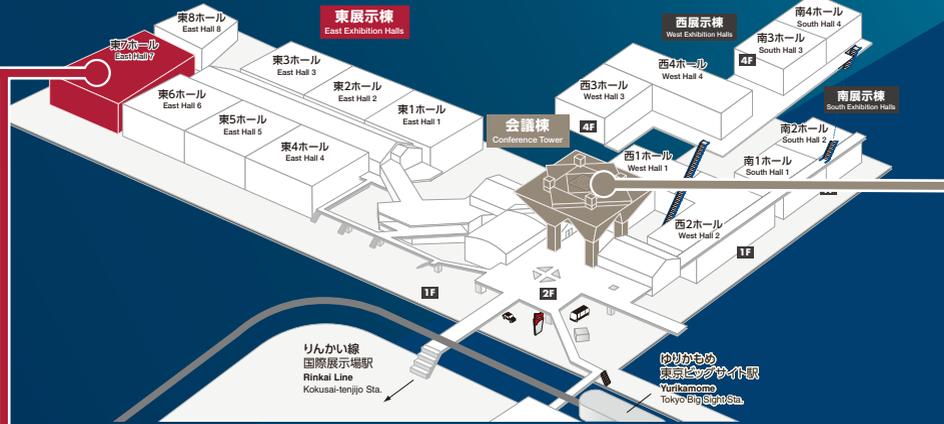
カーエレクトロニクス技術展

カンファレンスプログラム

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月23日 [木]

Jan.23 [Thu.]



カンファレンス会場A CONFERENCE VENUE A

AUTO-EV3 10:00-11:30
2027年のxEVに求められる電気駆動システム(e-Axle)の技術潮流とそのシステムインパクト
Technical Trend and System Impact of Electric Drive Power Train (e-Axis) for xEV in 2027
名古屋大学 未来材料システム研究所 未来エレクトロニクス集積研究センター 教授 山本 真樹
Toyota Motor, Future Material System Research Center, Future Electronics Integrated Research Center, Prof. Makoto Yamamoto

AUTO-EV51 12:30-13:40
マルチバスケイ戦略の鍵となる技術
Key Technologies for "Multi-baskey" Approach
トヨタ自動車(株) パワートレインカンパニー フレジデント 上原 隆史
Toyota Motor, Power Train Division, President, Takashi Uehara

PDM-S2 15:00-16:10
パワーデバイス サミット ~パワーデバイスの現状と展望を徹底討論~
Power Device Summit: Panel Discussions on the Current Situation and Future Outlook of Power Devices
インフオニオテクノロジーズ ジャパン(株) イングストリアム&インフラストラクチャー 事業本部 事業本部長 加藤 毅
Infonion Technology Japan, Inc. Inngstrom & Infrastructure Business Dept. Business Unit Manager, Takashi Kato

AUTO-EV3 10:00-11:30
富士電機(株) 半導体事業本部 開発技術部 統括部長 大西 俊彦
Fujitsu, Semiconductor Business Dept. Development Technology Dept. Chief Manager, Shunichi Nishi

ROOM(株) パワーデバイス事業本部 アプリケーション戦略室 アンシイノヴェーション(イノヴェイション) 渡部 幸典
Room, Semiconductor Business Dept. Application Strategy Room, Anshinovation (Innovation) Dept. Chief Manager, Yuki Watabe

カンファレンス会場B CONFERENCE VENUE B

NEPCON-S3 10:00-11:10
AIは産業をいかに変革するか ~要素技術から未来の姿まで徹底解説~
How AI is Transforming Industries - Explanation from Underlying Technologies to Future Prospects
富士通(株) 富士通研究所 人工知能研究所 所長 園田 俊浩
Fujitsu, Fujitsu Research Institute, AI Research Institute, Director, Shunichi Sonoda

WEA-S1 12:30-13:40
次世代ウェアラブルの誕生秘話! デバイス開発の最前線を追う
Frontiers of Wearable Device Development! The Inside Story of Next-Generation Wearables
サンテックグループ(株)イノベーションセンター(株) 社長 村上隆夫
Santec Group, Innovation Center, President, Takao Murakami

注意事項 Caution

● 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
● テキスト(講演資料)の配付はございません。
● カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

会議棟 CONFERENCE TOWER

7 国際会議場 INTERNATIONAL CONFERENCE HALL

ISP-3 10:00-11:30
次世代半導体パッケージにおける最先端実装技術動向
Leading Trends in Emerging Technology for Next-Generation Semiconductor Packaging
パナソニック(株)エレクトロニクス事業本部 パッケージングソリューションセンター センター長 轟山 龍一
Panasonic, Electronic Business Dept. Packaging Solution Center, Center Manager, Ryuuichi Hoshikawa

AUTO-SDV4 12:30-14:00
SDVの次世代技術ロードマップと統合ECU開発
Next-gen. Technology Roadmap for SDV and Integrated ECU Development
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター ソフトウェア開発 チーフソフトウェアアーキテクト 今井 孝志
Toyota Motor, Digital Software Development Center, Software Development, Chief Software Architect, Takashi Imai

AUTO-ONS1 15:00-16:10
自動車の資源循環モデルの確立と最新技術開発
Establishment and Latest Cutting-edge Technologies for Circular Economy in Automobiles
道徳者 環境共生・経済環境部 総務 資源循環ビジネス推進室 資源循環ビジネス推進室長 河田 隆平
Mitsubishi Motors, Environmental & Economic Environment Dept. General Affairs, Resource Circulation Business Promotion Room, Resource Circulation Business Promotion Room Manager, Ryuuhei Kawada

AUTO-CN3 10:00-11:30
車体のカーボンニュートラルに向けた新技術
New Technology to Achieve Carbon Neutrality in Vehicle Body Production
東京建設(株) グリーンEV開発事業推進 プロジェクト上級マネージャー 中西 栄二郎
Tokyo Koseki, Green EV Development Business Promotion, Project Senior Manager, Eiji Nakanishi

SL-E1 13:00-13:40
サステナブルなロジスティクスの構築を目指して ~オルビス流DX推進の取組~
Aiming to Build Sustainable Logistics with Style (Orbis Flow DX Promotion Initiatives)
オウルズ(株) SCM部 ロジスティクス開発グループマネージャー 柳田 和宏
Owls, SCM Dept. Logistics Development Group Manager, Kazuhiro Yanagida

SL-E2 15:00-16:30
M&Aは人手不足の運輸業を救うのか? 成功事例から学ぶ
Can M&A Solve the Labor Shortage in the Transportation Industry? Lessons From Successful Cases
フジノホールディングス(株) マーケティング部 執行役員 川上 義生
Fuji no Holdings, Marketing Dept. Executive Director, Yoshiki Kawasaki

PWB-3 10:00-11:30
実用化が見えてきたガラスサブストレートの必要性、課題、世界動向について語る
Glass Substrates are beginning to be Put to Practical Use. Talk About Needs, Challenges and Global Trends
エスエー(株) 電子・材料・生産技術開発部 総務・発行技術開発課 長 吉川 眞一
ASAHI TRONICS, Dept. Manager, Material & Manufacturing Engineering, Dept. Sec. & Material Technology Development, Sec. Manager, Makoto Yoshikawa

ISP-4 15:00-16:30
圧倒的な低消費電力化で半導体プレイヤーを変える光電融合技術
Optoelectronics - Ultra-low Power Consumption is a Game Changer for Semiconductors
(株) 東芝電機総合研究所 プラットフォームテクノロジー研究センター 主任 鈴木 周
Sharp, Research Center, Platform Technology Research Center, Chief, Shuuji Suzuki

AUTO-MS2 10:00-11:10
世界のMaas事例 ~中国のロボタクシーや無人運転サービス社会を学ぶ~
(Case Studies) Overseas Maas - Robotics in China and Driverless Mobility Service
現代文化研究所 調査・研究本部 総務(総務) 上長(主任) 八杉 理
Modern Culture Research Institute, Research Dept. General Affairs (General Affairs) Senior Manager, Ritshi Yashiki

FIW-S4 12:30-13:40
中小企業のGXどう進める? 政府の取り組みと事例を紹介
Group Transformation of SMEs - Initiatives and Case Study
経済産業省 GXグループ GX推進会議長 萩野 淳平
Ministry of Economy, Trade and Industry, GX Group, GX Promotion Meeting Chairman, Junpei Hagiwara

FIW-S5 15:00-15:40
バーチャルファクトリーの価値を考える
Considering the Value of Virtual Factories
日工機工(株) 代表取締役 セールズグループ マネージャー 三橋 修
Nissei Koki, Representative Director, Sales Group Manager, Tamihiro Mitsuhashi

FIW-S3 10:00-10:40
社会実装におけるヒューマノイドロボットの無限の可能性
Viable Possibilities of Humanoid Robots in Social Implementation
Boston Dynamics Inc., Chief Strategy Officer, marc theermann

NEPCON-K 12:30-13:40
半導体における最新技術戦略と展望とは
Latest Technology Strategy and Future Outlook in Semiconductor
SK hynix Inc., HBM Design Dept., Director, Hyunwoo Kim

PWB-4 15:00-16:30
次世代パッケージ基板技術の最前線
Cutting-edge Technologies in Next-generation Package Substrates
(株) レジナック PhotocellグループGX推進会議総務グループマネージャー 菅原 謙介
Resinac, Photocell Group, GX Promotion Meeting General Affairs Group Manager, Kenji Sugawara

マイページはこちら ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込はこちら REGISTER NEW SESSION FROM HERE

カンファレンスプログラム

CONFERENCE VENUE OVERVIEW

1月24日 [金]

Jan.24 [Fri.]



カンファレンス会場A

CONFERENCE VENUE A

NEPCON-S4
10:00-11:10
はんだ最新線！国際規格と先端技術の最新動向
The Frontline of Soldering: Latest Trends in International Standards and Advanced Technologies

(株)東海理化 生産開発部 総合生産室 室長 鈴木 貞人
トヨタ自動車(株) デジタルソフト開発センター 電子性能開発部 グループ長 西森 久雄

AUTO-SDV52
12:30-13:40
ソフトウェアファーストが生み出す
新たなモビリティの価値
The New Value of Mobility Created by Software-first

(株)NTTデータ 取締役社長執行役員 有馬 勲
(株)デンソー 上席執行役員 モビリティエレクトロニクスグループ長 近藤 浩

PDM-S3
15:00-16:10
カーボンニュートラルを実現する
パワーデバイス技術とは
Power Devices which Help to Achieve Carbon Neutrality

(株)安川電機 執行役員 インバータ事業部長 兼 インバータ技術部長 博士(工学) 井手 耕三
(株)TMEIC 執行役員 パワーエレクトロニクスシステム事業部 事業部長 飛田 正孝

カンファレンス会場B

CONFERENCE VENUE B

WEA-S2
10:00-11:10
進化する建設現場！ウェアラブル導入で生まれた
建設現場革新の実例と成果
Case Study: Innovations in Construction Sites Driven by Wearable Devices

(株)竹中工務店 広島支店 生産総務部 プロダクトグループマネージャーフェーズパートナー 二宮 義典
オリンクス(株) 事業本部 第二チーム 統括 加藤 孝子
セーフィー(株) 事業本部2Cビジネスユニット 統括 進部 郁巳

AUTO-CN4
12:30-14:00
サーキュラーエコノミーを実現する
自動車のアルミニウムリサイクル技術
Recycling Technologies of Automotive Aluminum Parts for Circular Economy

(株)UACJ マーケティング/技術本部 R&Dセンター フェデロ 見島 洋一
日産自動車(株) 企画・先行技術開発本部 材料技術部 車両材料開発グループ主管 瀧島 文彦

AUTO-SDV5
15:00-15:50
SDV実現に向けた開発効率化へのアプローチとは？
Increasing Development Efficiency to Realise SDVs

ボッシュ(株) ボッシュモビリティ 東アジア-東南アジア 技術統括部門 技術統括-エンジニアリング統括 森田 泰弘

注意事項 Caution

- <注意事項>**
- カンファレンス受講に必要な持ち物は2点です。
 - ① 展示会場入場に必要な来場者パス①
 - ② カンファレンス受講に必要な受講券②
- 敬称略、都合により講師、プログラムの内容が変更になる場合がございます。
- テキスト(講演資料)の配付はございません。
- カンファレンスの録音、写真、動画撮影などは一切禁止させていただきます。

*1 カンファレンスのお申込みとは別に、事前に展示会の来場登録が必要で、来場登録後にメールにて届く「来場者パス」をカラー印刷して当日必ずご持参ください。
*2 カンファレンス申込後に届く申込完了メールより受講券をダウンロードし、当日カンファレンス受付で提示してください。(印刷・スマホ上での提示、どちらでも可)

- < Caution >**
- You have to prepare the following items for attending conference.
 - 1. Visitor Badge for entering exhibition.
*Please register beforehand. A confirmation e-mail with visitor badge will be sent to the email you registered. Download and print with/without the visitor badge in advance and bring it with you to the exhibition.
 - 2. Conference Ticket.
*You must attach conference ticket attached with it to be sent to your email. Show the conference ticket (printed or show it on phone) at the reception of conference venue.
- Please be at the venue ahead of time to avoid congestion.
- Recording and photography are strictly prohibited.
- Speakers and programs are subject to change.
- Textbooks of Keyword/Special Sessions are not available.

マイページは
こちらから
ACCESS MY PAGE FROM HERE

新規申込は
こちらから
REGISTER NEW SESSION FROM HERE

会議棟 CONFERENCE TOWER

7
国際
会議場
INTERNATIONAL
CONFERENCE HALL

ISP-5
10:00-11:30
クルマの未来を切り開く
最新半導体テクノロジー
The Latest Semiconductor Technology to Open Up the Future of Cars

PWB-6
12:30-14:00
6Gに向けた次世代高速通信向けの
開発・技術動向
Next-generation high-speed application development and technology trend for 6G

6
606

FIW-S6
10:00-11:10
見える化でカーボンニュートラル！
スコープ3を見据えた取り組み
Carbon Neutral Manufacturing by Visualization, with Scope 3 in Mind

AUTO-EV4
12:30-14:00
次世代モータ開発
～環境、調達リスクの2大課題解決へ～
Next-Gen. Motor Development - To Overcome Environmental & Procurement Risks

SLE-S3
15:00-16:10
サステナブルでグリーンな物流を実現！
先進的な取り組みから学ぶ
To Achieve Sustainable Logistics: Learn From Latest Case Studies

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL
A

FIW-C
14:00-16:00
生成AIがもたらす製造現場の変革
Generative AI Will Transform the Manufacturing Workplace

1
レセプション
ホール
RECEPTION HALL
B

PWB-5
10:00-11:30
パワーデバイスの活用に向けた
パッケージング技術と部品内蔵基板技術
Semiconductor Packaging and Embedding PCB Technology to Utilize Power Devices

ISP-6
12:30-14:00
次世代パワーデバイスと
先端パワエレモジュールの世界
World of Next-Generation Power Devices and Advanced Power Electronics Modules

FIW-S7
15:00-15:40
5Gによる工場のDX化推進
Promotion of Factory DX Using 5G

(株)NTT-E Chief Standardization Officer 中村 健哉